

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、光電產業、精密機械產業、汽車產業、與消費性電子產業有關之各種連接器、機殼、散熱器、組裝產品以及網路線纜裝配等產品之製造、銷售與服務。本公司目前所生產之產品範圍包括：

1.I/O 產品線：IN-PUT、OUT-PUT 連接器。

2.IC 線路包裝與擴充記憶體產品線：IC 線路與記憶 IC 擴充卡架連接器。

3.系統連接器產品線：主系統與分支系統電路連接器。

4.網路連接與輸出裝置產品線：終端機、掃描器、鍵盤、顯示器、滑鼠、與網路整合連接線纜產品。

5.光電連接產品線：數位網路用光纖連接器與連接線網路。

6.具電子處理功能之複合式連接器：濾波連接器、防靜電連接器、高頻連接器。

7.新工業標準 EISA 介面卡連接器：開放架構擴充槽連接器。

8.機殼、散熱器、精密金屬加工零件與工程塑膠組件、資訊產品用之精密機械零組件、準系統、消費性電子產品。

9.記憶體組裝加工。

10.寬頻通訊產品、無線移動式通訊產品、局端通訊產品。

11.乙太網路交換機產品、無線網路產品。

2.營業比重方面

100% 來自於 3C 電子 (Computer, Communication, Consumer Electronics) 產品。最近二年度生產量及銷售量值，請參閱產銷量值表。

3.目前產品項目

本公司產品涉及 3C 電子產品領域的零組件、模組、系統組裝產品，其中零組件可包括 3C 連接器、線裝產品及其他零組件；模組可包括機械模組(如 3C 產品機殼)及電子模組(如 3C 產業的表面黏著產品)；系統組裝主要為 3C 產品的成品組裝。

4.計劃開發之新商品

本公司對於未來新產品研發方向，將朝向複合式、模組化、高頻、光電、表面黏著等類型連接器發展，以因應 3C 電子產品之漸趨輕、薄、短、小化、表面黏著化、模組系統化、電腦與通信整合化之潮流趨勢。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

回顧一〇七年，主要國家經貿表現依舊強勁，資本密集型投資和消費需求皆上升，不過隨著美國逐步調整貿易政策與持續緊縮貨幣政策，影響層面從企業信心擴散至實體經濟，全球金融市場在第 4 季產生劇烈波動，加上油價重挫，廠商需求轉為保守，令中國、日本、韓國第 4 季進出口表現大幅衰退，美歐近期 PMI 表現亦不如預期，顯示全球經濟成長可能面臨趨緩。美國經濟在一〇七年表現亮眼，民間投資提供了最主要的成長動能，然而國際機構包括 IHS Markit、英國經濟學人資訊中心、國際貨幣基金與世界銀行則認為一〇八年的美國經濟成長將較一〇七年趨緩，經濟成長率約落在 2.3-2.5%區間。展望今年，就近期國際預測機構如國際貨幣基金組織(IMF)、世界銀行(WB)與 IHS Markit 所公布之更新數據觀察，有鑑於美中貿易協商前景未明、中國經濟放緩、歐洲成長疲軟、英國可能無協議脫歐的衝擊，IMF 下修一〇八年全球經濟成長率 0.2 個百分點，WB 和 IHS Markit 皆下修 0.1 個百分點。儘管一〇八年的全球經濟表現恐不如一〇七年，惟減幅有限，此外美中貿易協商已開始進行，美國與其他國家的貿易協商也將在今年陸續啟動，然在部分關鍵議題上，雙方仍有分歧，協商結果是否順利，有待後續觀察。

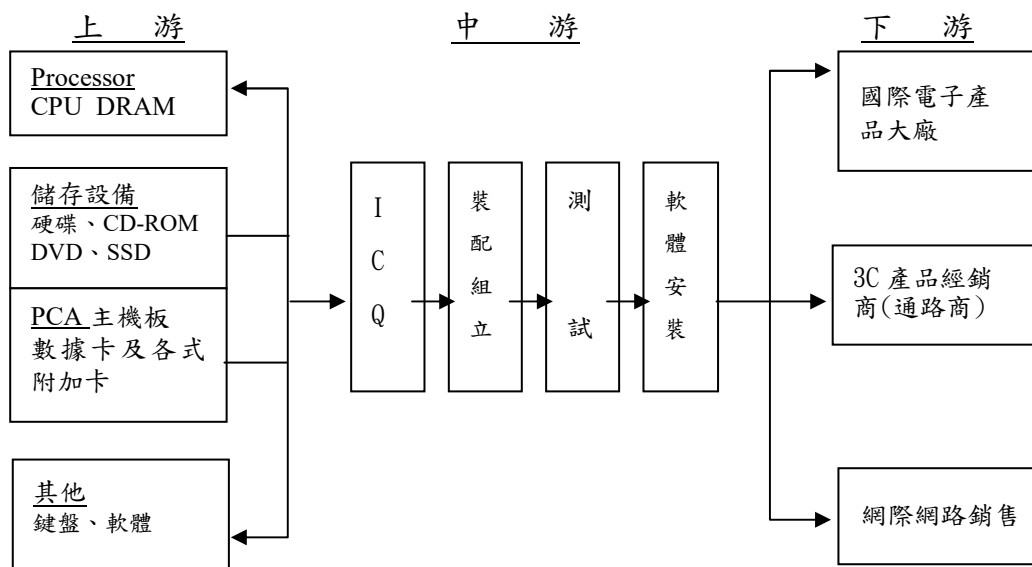
以電子產業而言，近年市場規模最龐大的產品仍屬智慧型手機。在行動網路覆蓋率與傳輸頻寬逐漸提升的帶動之下，智慧型手機已經融入消費者的各個生活層面，全球眾多廠商更是積極投入以爭取商機。然而根據國際數據資訊(IDC)的統計，一〇七年全球智慧型手機出貨量為 14 億支，年減 4.1%，主要反映出智慧型手機的普及率提升且消費者缺乏換機的動機。展望一〇八年，IDC 仍預估全球智慧型手機市場將衰退 0.8%，出貨量達到 13.9 億支的規模。

在平板電腦方面，根據 IDC 統計，一〇七年全球出貨量為 1.50 億台，較一〇六年衰退 8.4%，且 IDC 預期一〇八年平板電腦出貨量將持續年減 8.7%至 1.37 億台，其中一般平板電腦出貨量在一〇八年持平約 1.15 億台，且預期未來幾年將持續衰退，年複合成長率為-4.4%；但可拆卸式的 2-in-1 裝置因兼顧娛樂與工作的需求，在一〇八年仍將成長，出貨量年增 0.8%至 2,210 萬台，且未來幾年的年複合成長率預估仍可達 4.6%。

PC 產業面臨智慧型裝置的取代效應，消費者換機時間拉長，近年持續呈現衰退趨勢。根據 IDC 統計，一〇七年全球 PC 出貨量持平於 2.57 億台，預期一〇八年仍將呈現小幅衰退走勢，全年出貨量估為 2.54 億台，年減 1.2%。其中桌上型電腦在未來幾年將持續衰退，預期年複合成長率為-2.6%，但筆記型電腦則較為穩定，未來幾年出貨量可望微幅成長，年複合成長率 0.7%。

至於新興的電子產業領域，例如物聯網、穿戴式裝置、電動汽車、機器人等，各家業者都以不同角度展開佈局，目前已發展出各自的優勢且可望逐漸商品化。

2. 產業上、中、下之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

近年來智慧型手機普及率上升之後，目前成長幅度已趨於平緩，一〇七年全球智慧型手機出貨量為 14 億支，年減 4.1%，主要反映出智慧型手機的普及率提升且消費者缺乏換機的動機。展望一〇八年，IDC 預估全球智慧型手機市場將持續萎縮，年減 0.8%，出貨量為 13.9 億支。

由於全球眾多手機品牌廠商爭相投入，產業競爭態勢愈趨激烈，導致市場朝向中低價智慧型手機發展，因此智慧型手機的平均銷售單價(ASP)持續下滑，且僅有極少數領導品牌能夠保持獲利。與此同時，品牌廠商為求差異化而必須不斷推陳出新，手機功能朝向更多元化發展，甚而必須推出自有的服務。可摺疊式設計、5G、曲面螢幕、雙鏡頭/相機功能進化、生物識別系統應用整合、模組化組件、電池容量加大、無線充電、全圖投影機、語音控制、虛擬助理功能與心情感應等，都是智慧型手機業者目前研發的方向。

根據 IDC 預測，Android 手機仍然會是智慧型手機市場的大宗，尤其是在中低階市場具有競爭力，一〇七年的全球 Android 手機出貨量約為 12.1 億支，到一一一年可望達到 13.6 億支，市佔率略增至 86.2%。iOS 手機在一〇七年的出貨量達到 2.10 億支，市佔率 14.8%。Android 與 iOS 手機合計在一〇七年的全球智慧型手機市佔率為 99.9%，IDC 預期此二作業系統將持續主宰智慧型手機市場，二者合計市佔率在一一一年將達到 100%。

以手機代工組裝產業來看，根據 IDC 資料顯示，在一〇七年第三季全球前 10 大智慧型手機組裝廠商之中，本公司排名第 2。

在平板電腦市場方面，Android 作業系統亦持續保持領先，一〇七年 Android 平板電腦出貨量為 1.05 億台，市佔率為 60.3%；iOS 平板電腦出貨量 4,490 萬台，市佔率為 25.8%；Windows 平板電腦出貨量為 2,430 萬台，市佔率 13.9%。然而值得注意的是，可拆卸式 2-in-1 平板電腦在微軟(Microsoft)大力推動之下獲得商用市場青睞，仍呈現快速成長趨勢。IDC 統計 2-in-1 平板電腦在一〇七年的出貨量為 2,250 萬台，成長率為 2.7%，到一一一年出貨量將可望成長到 3,460 萬台，年複合成長率為 8.7%。

根據 DIGITIMES Research 資料顯示，在一〇七年第三季的全球平板電腦代工廠中，本公司排名第 2。

PC 產業近年面臨使用者缺乏換機動機導致換機週期拉長、以及智慧型裝置功能逐漸增強至可以取代 PC，因此整體市場呈現疲弱，一〇七年全球 PC 出貨量持平於 2.57 億台，IDC 預期一〇八年將微幅衰退，全年出貨量估為 2.54 億台，年減 1.2%。其中桌上型電腦在未來幾年將持續衰退，預期年複合成長率為-2.6%，但筆記型電腦則較為穩定，未來幾年出貨量可望微幅成長，年複合成長率 0.7%。

新興的電子產業如物聯網、穿戴式裝置、電動汽車、機器人等，目前仍處於早期發展階段，不過各家業者都以不同角度展開佈局，且已發展出各自的優勢並可望逐漸商品化。

(三)技術及研發概況

1.所營業務之技術層次、研究發展

本公司以獨特的經營模式 IIDM-SM，橫跨整合(Integration)、創新(Innovation)、設計(Design)、製造(Manufacturing)—銷售(Sales)、行銷(Marketing)」等服務，結合精密模具、材料科技、環保綠製程技術、SMT 製程技術、熱傳技術、塑膠加工、金屬加工、測試能力、自動化能力、機光電整合技術、主機板設計、電子商務、伺服器設計、無線通訊與光顯示模組等既有的核心競爭力，在 6C (資訊、通訊、消費性電子、汽車、通路、數位內容)代工領域，持續為全球策略夥伴客戶提供最佳的服務，替股東創造最大的價值。

展望未來，企業競爭力之所在，維繫於不斷創新及研發；本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、量產化研究與系統化管理，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位。

2.最近年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位：新台幣仟元

項目\年度	107年	108年1-3月
研發費用	84,430,083	17,872,966
研發費用占營收淨額%	1.59%	1.70%

3.開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
107年	<ol style="list-style-type: none"> 1. HD/FHD 32/40吋(DLED) for India ATV 2. UHD 60/70吋(DLED) 第二代 Cast (HDR) TV for NA 3. 全平面式超薄、輕、極簡、廣色域 65" & 70" 8K 無線影像電視(先進技術開發) 4. 第三代電梯顯示屏設計開發(先進技術開發) 5. 8K 科技農業服務與應用：開發影像辨識來辨識蔬菜成長率(先進技術開發)。 6. 玻璃導光板結合玻璃背板顯示器 7. INTEL RealSense 3D FID 臉部辨識模組開發 8. 大廣角 Active Alignment 設備開發 9. 大廣角 影像測試系統 10. 雙OIS Dual CAM AA 機開發 11. UHD 80吋(DLED)Smart TV (voice control) for Taiwan 12. HD/FHD 32/40吋(DLED) 第二代 新MB(HDMI靜電防護) 13. 高動態範圍顯示(HDR)技術的實現，讓TV擁有高動態、廣色域同時能提供豐富的亮暗區域細節 14. TV overscan自動化測試程式開發 15. Boot to IPTV (Youtube,Netflix)功能開發 16. TV22""",24""",29"" 面板夾持固定結構設計與專利申請 17. Hole type 異形顯示屏技術應用 18. 掃地機器人之距離感應sensor模組開發 19. 雙頻高隔離度天線設計for WIFI Module 20. 激光超短焦投影機技術：激光光源技術、IP5X防塵光機、超短焦鏡頭、觸控模組技術 21. 激光商務/教育投影機技術：MCL激光模組技術、全封閉式防塵光機、鏡頭垂直位移機構、環境光偵測補償技術

年度	開發成功之技術或產品
108年 1- 4月	1.UHD 60/70吋(DLED)第三代Smart Cast TV for NA 2.TV操作盲人聲音輔助系統 3.HelpGuide For user interface 4.TV 後殼彈性卡配結構設計與專利申請(無螺絲架構設計、外觀美化) 5.VoLTE(HD+)之聲學調教技術開發 6.聲學降躁技術之開發導入 7.智慧型手機之熱管理技術開發 8.智慧型手機符合新式安規IEC62368之設計開發 9.寬頻高增益全向天線設計 10.用中框鐵件來設計手機的2/3/4G、GPS和BT/WiFi天線，創新設計可節省天線的生產與製造成本 11.工廠抽樣檢測軟體之開發 12.RDL站軟體一對多燒錄機制之開發 13.廣色域投影機技術：4K超高清解析度、95% DCI-P3色域、ISF調校技術、MEMC動態補償、HDR10/HLG高動態範圍顯式技術、鏡頭自動光圈高對比顯示技術

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期業務發展計畫

本公司以卓越的運籌管理與成本控制能力，提供「一站購足」的解決方案，主要客戶均為全球知名的領導廠商，供給國際客戶更優質的服務與附加價值，進而使全人類皆能享有電腦、通訊、消費性電子(3C)等產品所帶來的便利生活，為本公司一貫追求的願望與目標。本公司將堅持既有目標，提供更多元的服務及爭取更多的商機，深化與國際大廠之合作關係。

為提供客戶更及時的服務，本公司在歐、美、亞三大洲積極佈局。本公司未來將持續於全球各地建立相關生產基地、設計中心、服務中心，以滿足客戶三區設計製造及全球組裝交貨的需求。

2.長期計劃發展方向

本公司在創新研發方面的投入不遺餘力，專業研發機構遍佈亞洲、美洲與歐洲三大洲，可進行日不落的研發接力，使新產品在最短時間問世。本公司在頂埔的全球研發中心總部，設有精密機械、精密模具及奈米科技研究所，主導創新的研究發展，並藉由全球研發總部的啟動本公司將更深化科技導向，除了持續研究發展新領域外，並將以創新技術應用於傳統製造方法，以提升品質、節省資源耗用，提升國際水準。

在此同時，公司也從大中華地區向外延伸，積極尋找美國、日本、韓國、德國、印度與東南亞的投資與合作機會，集結世界級的技術與人才，與策略合作夥伴進行業務互補，強化公司的長期競爭優勢。

本公司就全球暖化問題多年來自身或協同產業組織 EICC（電子產業公民協會）從節能、減排、綠化、循環等環保方面持續努力推動與奉獻，展望一〇八年，本公司更將藉由提供創新軟體與科技服務，拓展環保/能源產業，呼應與強化全球節能、減排等環保意識。同時本公司將更積極透過開放分享集團全球的整合平台優勢與所有志同道合之優質企業及人才，循『構建平臺、並肩作戰』模式，共同經營全球的經濟版圖，謀求股東、客戶、員工、策略夥伴、社會大眾及經營層的共同利益，積極以高標準公司治理推動有能力者承擔更多的社會責任(SER)，加速提升產業的整體國際競爭力，並為股東謀求更大價值。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1.主要產品、服務銷售及提供地區

(1)零組件

電腦連接器為本公司主要產品之一，該項產品主要為電腦設備的神經，大量使用於資訊產品、通訊設備及消費性電子產品上，產品種類主要以本公司規格產品為主，客戶委託設計為輔，在國內市場本公司為領導性廠商之一，業務推廣由業務部負責中大型客戶，其他小型客戶之業務則委由國內經銷商推廣。在國外市場，則由辦事處或海外子公司轉交訂單或督導當地代理商、經銷商推廣業務。

(2)模組

本項產品的規格大部份由客戶委託設計；在國內市場，業務推廣完全由業務部門直接負責；國外部份，則由海外公司負責督導當地代理商、經銷商推廣業務及銷售服務。

(3)組裝產品

係整合連接器、線纜配組、電腦基座、表面粘著產品、記憶體、中央處理器、相關軟體等資訊、通訊及消費性電子產品組裝、生產及銷售，主要銷售地區涵蓋歐、美、亞三大洲。

2.市場占有率

根據彭博市場調查機構 (Bloomberg)統計，本公司在一〇六年電子代工服務領域(EMS)之全球排名為第一名，市佔率接近全球四成(39.6%)。

3.未來市場供需狀況與成長性

本公司產品的主要應用領域包括通訊產品(手機、網路產品)、消費性電子、電腦及其週邊商品等，上述產業的發展概況如下：

A.智慧型手機

IDC預期一〇八年智慧型手機市場的成長率將年減0.8%，出貨量可達13.9億支，到一一二年可達到15.4億支的出貨量，年複合成長率為1.7%。

目前看來，美國、西歐均已屬於成熟市場，當地手機出貨量成長已趨緩，未來智慧型手機市場的成長動能將來自新興地區。其中，中國在4G LTE覆蓋率提升之後，進一步推升LTE智慧型手機用戶數，中國智慧型手機品牌已逐漸成熟且市佔率逐漸上升。根據IDC統計，一〇七年第三季全球智慧型手機品牌銷售量前五名分別為三星(年減13.4%、市佔率20.3%)、華為(年增13.4%、市佔率14.6%)、Apple (年增0.5%、市佔率13.2%)、小米(年增19.6%、市佔率9.5%)及OPPO (年減1.9%、市佔率8.4%)。此外，印度也是快速成長的地區，由於當地智慧型手機滲透率仍低，且當地電信商持續提升一、二線城市之外的網路覆蓋率，吸引智慧型手機大廠積極投入，預期將會是未來帶動全球智慧型手機出貨量成長的主要動能之一。

智慧型手機硬體發展多年，高階產品差異化和創新仍持續發生，大廠為增加手機附加價值和收入來源，智慧配件成為大廠進行創新的重點，衍生出手環、手錶與外接式鏡頭等產品。此外，手機品牌廠也紛紛導入4K螢幕、曲面螢幕、雙鏡頭/相機功能進化、生物識別系統應用整合、模組化組件、電池容量加大、無線充電、全圖投影機、語音控制、虛擬助理功能與心情感應等功能，期望藉此提升產品差異化。

全球智慧型手機品牌客戶持續擴大委外，加上手機的外型越來越輕薄、功能卻持續提升，內部零組件與機構的複雜度與精密度更勝以往；因此，具有高度垂直整合能力、且有量產實力的製造業者，可協助品牌客戶降低成本，提升競爭力，未來仍有許多發展機會。

B. 平板電腦

平板電腦市場過去兩年雖逐年衰退，IDC預期一〇八年平板電腦全球出貨量將為1.37億台，且到一一二年估衰退至1.22億台，年複合衰退率為2.8%。

IDC預期可拆卸式2-in-1平板電腦仍會保持成長，市佔率將從一〇七年的5.5%成長到一一二年的7.1%。這種搭配鍵盤的可拆卸式平板電腦，可滿足使用者的多元需求。在如微軟Surface系列等可拆卸式平板電腦的推動之下，目前許多業者亦積極投入，除了PC品牌業者之外，許多手持裝置業者也躍躍欲試。

以尺寸類別來看，IDC評估，8吋以下的小尺寸平板電腦受到大尺寸智慧型手機的擠壓，因此將持續衰退；未來的平板電腦產品，將著重在8吋以上、甚至超過9吋的大尺寸市場，藉由較大的螢幕，搭配鍵盤設計，滿足使用者內容生產的需求。

C. 電腦產品

相較於智慧型裝置產業，Wintel陣營所主導的PC產業，近年相對缺乏話題性，Windows作業系統與Intel晶片的升級，已經無法再像過去一樣創造大規模的換機效應。IDC認為，在成熟市場裡，PC只剩下單純的替換需求，而在新興地區，PC的成長也不明顯，因為智慧型手機與平板電腦已經滿足了許多消費者需求。不過，PC在企業領域依然有不可取代的地位，其文書處理、檔案編輯、

內容創造的便利性，不易被智慧型裝置取代，因此整體PC市場規模仍然相當龐大。此外，在消費市場，PC朝輕薄化、小型化發展，業者仍有發揮創意的空間。

IDC預期全球PC出貨量在一〇八年將小幅衰退1.2%至2.54億台，預期一一二年的出貨量約2.51億台，年複合衰退率為0.4%。

PC產業走過成長期，產業已經逐漸整併，許多小型品牌相繼整併或退出，過去廠商之間的競爭已趨於和緩。在此大環境下，資源較豐富、具備垂直整合能力的大廠，仍屬相對有利。

D. 雲端運算產品

主要的產品包括伺服器、儲存設備和網通設備，相關產業概況如下：

(i) 伺服器/儲存設備

雲端運算風潮興起，許多商業資料已經脫離企業的實體圍牆，轉而儲存到雲端業者的平台上，而運算也委外給雲端服務業者，伺服器產品跟著發展演化。DIGITIMES Research估計，一〇七至一一二年之間伺服器出貨量的年複合成長率為14%，維持高成長幅度，其中企業換機潮及雲端服務業者持續展現需求是推動整體伺服器產業成長的主因。

企業與雲端服務業者的資料處理需求日益增加，加上大數據(Big Data)相關技術與解決方案的成熟，大量、多樣化的資料格式必須快速儲存，而主儲存設備、備份及災難復原解決方案的需求，亦推升儲存設備的市場向上成長。如今，可彈性擴充的儲存設備成為新的發展方向，搭配得以優化硬體使用效率的軟體，讓企業與雲端客戶得以打造更具成本效益的儲存架構。

(ii) 交換器與路由器

4G 通訊的普及、大數據資料中心的興起和物聯網的推展，帶動網路流量大增，各國業者積極擴充4G LTE與光纖設備，強化相關基礎建設。為確保順暢的流量傳輸、降低資料庫回應時間，雲端業者持續投資相關設備。根據IDC統計，全球乙太網路交換器市場的營收在一〇七年成長了9.1%，整體市場仍屬健康發展。

4. 競爭利基

精密開模技術

具備從塑膠成型、沖壓、模流到機械零組件的垂直整合製造能力

內部高速連結系統的建立

機械及準系統設計能力

熱傳及噪音處理技術

SMT 軟硬體的測試技術

PCBA 的快速量產能力

光機電整合能力

全球供應鏈的管理能力

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

全球產業結構繼續進行調整，3C 電子產業的國際級大廠委外代工比例逐年增加，有利本公司爭取商機。

3C 電子業產品週期不斷被壓縮，速度的重要性持續爬升，eCMMS 於速度、品質、工程服務、彈性、成本的優勢有利本公司爭取商機。

海外生產體系完整，配合客戶全球生產製造，經營良好。

在全球廣設生產及行銷據點，增加全球資源整合運作的彈性及效益。

標準化、電腦化、自動化。

建立工管、品管、生管、經管的協力運作體系。

掌握模具開發、新產品開發等關鍵技術。

(2)不利因素與因應對策

台灣內需市場成長空間有限。

因應對策：在全球主要市場皆擁有完整的策略性佈局，不僅得以取得當地相較低廉之成本，並能提供對國際客戶更即時的服務。此全球佈局因本公司的執行力及 eCMMS 經營模式得以形成公司對拓展國際市場的競爭力。

部分原材料仰賴進口，台灣自製率稍低。

因應對策：本公司長期經營連接器相關產品，深知上游供應商之供應狀況，一方面扶植國內供應商以降低成本、縮短交期，一方面與國際大廠維持友好關係，確保數家以上之供貨來源。

土地取得成本較高。

因應對策：為因應國內土地取得成本過高，已將部分生產線移往土地成本較低之地區，以求資源配置效率化與分散區域風險。此外，本公司在全球廣設行銷據點與配發中心，增加全球資源整合運作的彈性及效益，提升對客戶的服務品質。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司產品區分為電子連接器、電子機殼、配組與組裝產品三大類，電子連接器可再分為 I/O(INPUT/OUTPUT) 與 INTERCONNECTION 類，I/O 類用於電腦主系統與週邊設備如滑鼠、顯示器、鍵盤、印表機、繪圖機及網路系統間之信號傳輸使用、產品類別：如 D 型連接器、圓型連接器、扁平式連接器、同軸連接器。

INTERCONNECTION 類應用於主系統與週邊設備內，為電子零件之裝載與電路印刷板之媒介及各系統內各模組間電氣訊號之連接，例如主機板與附加卡、電源供應器，產品類別如板緣連接器、機體電路插座、扁平式電纜線組成及其連接器、各類型插頭、插座等。近年來隨著電腦功能之增強，相關聯週邊設備增多，網路系統架構之需求，故 I/O 類連接器之使用量也日漸增加，另 INTERCONNECTION

類連接器，因應電腦系統設計，製造模組化趨勢，整體使用量亦趨增加。

線纜配組，主要為配合客戶之應用需求設計製造，目前產品類別，依應用功能區分為顯示器用、滑鼠用、鍵盤用、電腦網路系統用、通信設備用等類別，及各類型具迴路功能之轉換器。

組裝產品為配合客戶需求設計，生產之各類型電腦基座及內部機構組成。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司產製之連接器及機座與組裝產品使用原料包括銅材、塑膠粒與金鹽、鋼材，供應狀況如述：

1. 銅材

與多家供應商策略結盟，以高品質銅材持續穩定的供應生產所需。價格決定以 LME 市場價格為基準作公式化計算，本公司設有專人統計分析趨勢，掌握低價時機採購，確保競爭力。

2. 塑膠粒

與國內、外廠商共同開發連接器專用材料，提高生產品質。廠商為本公司設立發貨倉庫於香港，確保供應穩定且縮短交期。以年度契約報價方式，掌握大宗採購優勢，確保價格競爭力。

3. 金鹽

價格以國際金價行情為基準，以公式化計算。廠商直接送貨至工廠降低本公司運輸風險。廠商每三至四天交貨一次，降低本公司庫存成本。

4. 鋼材

與國內外多家廠商共同開發電腦基座用材料。以年度契約或市場價格報價，掌握採購優勢提高價格。

5. 其他有關組裝及記憶體產品，所需原料包括印刷電路板、電容、IC 等，此產品係配合客戶需求之加工性質，有關原料皆可透過客戶直接取得。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名單

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣佰萬元

項目	106年			107年			108年度截至前一季止					
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	L 廠商	1,313,013	31.54%	無	L 廠商	1,538,917	33.64%	無	L 廠商	260,136	28.21%	無
	其他	2,850,194	68.46%	-	其他	3,035,079	66.36%	-	其他	662,076	71.79%	-
	進貨淨額	4,163,207	100.00%	-	進貨淨額	4,573,996	100.00%	-	進貨淨額	922,212	100.00%	-

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣佰萬元

項目	106年			107年			108年度截至前一季止					
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	戊客戶	2,406,403	51.13%	無	戊客戶	2,612,695	49.35%	無	戊客戶	504,969	47.90%	無
	其他	2,300,333	48.87%	-	其他	2,681,108	50.65%	-	其他	549,334	52.10%	-
	銷貨淨額	4,706,736	100.00%	-	銷貨淨額	5,293,803	100.00%	-	銷貨淨額	1,054,303	100.00%	-

(五)最近二年度生產量值

單位：仟個、新台幣仟元

生產量值 主要產品	106 年度			107 年度		
	產能	生產量	生產值	產能	生產量	生產值
3C 電子產品	23,867,068	21,574,158	3,012,600,124	17,258,308	15,599,784	2,749,382,969

(六)最近二年度銷售量值

單位：仟個、新台幣仟元

銷售量值 主要產品	106 年度				107 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
3C 電子產品	86,315	12,492,676	21,492,361	3,073,557,528	62,709	11,578,497	15,130,285	2,793,634,307
勞務及管理費收入	—	—	—	32,035,472	—	—	—	62,735,789

三、最近二年及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		106 年度	107 年度	當年度截至 108 年 4 月 30 日
人 數	職 員	153,692	179,969	169,899
	作 業 員	649,434	487,711	431,377
	合 計	803,126	667,680	601,276
平 均 年 歲		28.51	31.45	32.58
平 均 服 務 年 資		3.63	3.77	4.02
學 歷 分 布 %	博 士	0.03%	0.04%	0.20%
	碩 士	0.99%	1.06%	1.13%
	大 專	16.34%	20.73%	21.19%
	高 中	39.01%	36.87%	37.26%
	高 中 以 下	43.63%	41.30%	40.22%

四、環境保護支出资訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失：無此情形。

(二)1.本公司主要廠房及生產設備位於土城工業區及竹科園區，平時即將環境保護工作列為重點事項，發現問題立即改善，並針對現有防治設備進行檢討，除給公司員工及附近居民良好之工作及生活環境外，更嚴格要求符合排放標準，對生產過程中所產生之污染及廢棄物，本公司採取之環保措施如下：

(1)水污染防治方面：在土城廠區設置廢水處理廠及水質分析實驗室。其中廢水處理採用化學方式處理，將廢水中之污染物去除，經放流口排放。而水質分析實驗室中有溫度、酸鹼度、化學需氧量、懸浮固體、重金屬分析等各項儀器，每日檢測放流水，即時做好放流水管控。本公司虎躍廠、民生廠、新竹廠及頂埔廠均已取得廢(污)水聯接使用污水下水道系統之同意函，函文字號分別為土服字第 1065061681 號、土服字第 0955060439 號及園勞字第 1000004253 號、土服字第 1035060107 號。

(2)固定污染源防制方面：廢氣經抽氣管線收集，進入濕式洗滌塔去除廢氣中之污染物後排進大氣中，每年委外檢測排放廢氣之污染物濃度，並申報至環保主管機關。固定污染源操作許可證已於民國 87 年取得，並於民國 97 年 6 月展延完成，許可證字號：北縣操證字第 F0447-02 號。目前由於酸鹼液總實際用量未達管制量，依環保局北環空字第 1012095840 號函指示繳回許可證。

(3)廢棄物清理方面：依事業廢棄物清理計劃書內容執行，並依法上網申報廢棄物流向，以合法清理廢棄物且回收資源廢棄物。

(4)毒化物管理方面：毒化物單獨貯存，嚴格做好管制，依法取得使用備查文件，並定期申報至環保主管機關。

2.本公司一直秉承“防治污染、持續減廢、提供符合環保產品、保護地球、務實經營綠色企業”的環境政策，嚴格遵守環境保護法律法規和客戶要求，有效管控原料、製程、出貨等各環節，並通過持續改善活動不斷提升產品的質量，確保所提供之產品不含限制使用之物質，同時推動上游供應商向綠色供應鏈的轉化，以符合 RoHS 法令的要求。

3.目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年預計之重大環保支出：

(1)未來二年預計環保資本支出

單位：仟元

	108 年度	109 年度
擬購置之防治污染設備或支出	無	無
預計改善情形	無	無
支出金額	無	無

(2)改善後之影響

●對淨利之影響	無	無
●對競爭地位之影響	無	無

五、勞資關係

現行重要勞資協議及實施情形：

本公司一向以誠對待員工，透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。本公司雖未設置產業工會之組織，但已依法成立並定期召開勞資會議，歷年來本公司員工亦能發揮出團隊精神，配合公司決策，彼此合作無間，使勞資之間充滿和諧的氣氛。公司遵守相關勞動法規、保障員工之合理權益、提供員工安全與健康的工作環境，並設有員工意見反應與申訴規範。以下是本公司致力於勞資和諧關係之具體措施：

(一)員工福利措施：

本公司於民國74年7月成立職工福利委員會，委員會係由15名委員組成，其中包括資方指派代表5人，及勞方推選代表10人，委員會每三年改選一次，委員會下設專任幹事員，專責辦理福委會日常行政工作。

此外，公司並設有健康衛生總處，特別針對員工及員工眷屬的健康促進與健康照護，提供一系列的福利措施。

目前本公司推動之福利措施如下：

1. 設置員工餐廳、食安檢測中心。
2. 贈送員工生日禮品(禮金)、節慶禮品等。
3. 嘉年華活動與摸彩。
4. 補助員工文康娛樂活動(如:建置員工健身房、設置盲胞按摩服務等)。
5. 健康促進活動(如：專題演講、減重活動等)
6. 健康及醫療諮詢。
7. 員工生育津貼、育兒津貼，並針對懷孕女性員工提供交通補助、營養保健補助、孕婦禮遇等照護措施。

- 8.員工結婚禮金及喪葬慰問金。
- 9.員工教育訓練補助。
- 10.員工團保。

(二)員工進修與訓練

教育訓練是本公司培育人才的重要工具之一。本公司鼓勵全體員工“工作中學習，學習中成長”，支持理論與實踐經驗相結合。透過教育訓練提昇個人素質，增加工作技能，增進團隊績效，促進集團“國際化、科技化、年輕化”經營目標之實現。本公司107年度辦理教育訓練時數達348,738小時，教育訓練費用約新台幣4,776,313元，訓練內容如下：

a.新進人員教育訓練

引領新進人員熟悉組織發展沿革與企業文化、工作環境、勞工安全衛生、總務服務、員工福利、人事規章、教育訓練制度、法務通識以及資訊安全等課程。

b.新幹班培訓計劃

為期 6 個月的新幹班訓練計劃分為三個部分，第一部分為集訓課程，讓新幹班以團隊小組討論方式，認識集團、了解各事業群產品、進行創新創意與問題解決課程，提升同仁軟實力與適應力；第二部分為產線實習，讓新幹班了解海外廠區產線與學習相關知識；第三部分為部門實習，讓新幹班在工作中學習，透過輔導員制度傳授工作知識。

c.管理能力發展

依照不同管理階層需求與晉升審核條件，為不同管理階層員工量身訂作管理能力發展訓練課程，協助主管做好準備，讓主管具備「建組織、佈人力、置系統」的管理能力。

d.鴻海工業互聯網學院

由工業互聯網學院訂定訓練政策、建立訓練管理系統及線上學習平台，使教育訓練流程化、簡單化、合理化、標準化、系統化、資訊化。

e. 國際化名人講座

邀請產業界各領域的國際頂尖人士蒞臨公司演講與交流，包含產業趨勢、人工智能、工業互聯網、大數據、機器人、工業 4.0 等領域。

f. 健康促進講座

由健康管理中心定期邀請健康促進、運動、心理、CPR、AED 各分面的專家開辦各季節合適課程，讓同仁下班後放鬆心情，並更深入吸取健康促進相關知識。

(三)員工行為或倫理守則

為了讓各職級員工瞭解倫理觀念、權利、義務及行為準則，本公司特別制定相關辦法與規定，讓所有員工能有所依循。相關辦法簡述如下：

- 1.核決權限及分層負責規定：為提高工作效率，加強分層負責管理及有效規範各職級員工在工作上權力。
- 2.各部門組織架構與各職務工作職掌：明確規範各單位之組織功能與各職務的職掌範圍。
- 3.編製員工手冊，協助所有同仁瞭解相關辦法與規定：
 - a.新進員工輔導課程：使新進同仁於報到後，及早消除對新環境的陌生感，儘快熟悉公司組織、文化、工作環境及人員，協助新進同仁在短時間內安排身心就緒，發揮生產力，並降低新進同仁流動率。
 - b.從業道德守則：為提升全體員工之行為素養、從業道德及專業能力，及在合法範圍內追求公司利益。每位員工有責任防止公司利益減損或流失及有義務維護公司之信譽，以確保公司永續成長與發展。
 - c.工作規則：明確規範各項勞動條件，人事管理規定等，使員工有所遵循。
 - d.員工出勤及請假管理辦法：健全考勤、請假制度以建立員工良好的工作紀律。
 - e.獎懲規定：對員工行為或動作導致公司在營運上之利得或損益給予獎勵或懲處。
 - f.員工績效考核：每年考核員工的工作成果及績效，作為調薪、升遷、獎金發放與教育訓練課程安排的依據。

(四)工作環境與員工人身安全的保護措施

- 1.公司於107年持續維持安全衛生管理系統，並通過SGS驗證公司認證，取得OHSAS18001及取得CNS15506證書。
- 2.公司訂有安全衛生政策並承諾追求零傷害、零職業病、零事故目標，創造全體員工最佳工作環境。
- 3.107年5月獲得「新北市政府」頒發「新北市敬業樂業安衛人員優等獎」及「新北市優良單位獎」。
- 4.員工人身安全：虎躍廠依據「事業單位無災害工時紀錄實施要點」，參加無災害工時紀錄競賽，已達九百零二萬一千八百五十八無災害工時紀錄；頂埔廠無災害工時紀錄為一百二十四萬小時。
- 5.工業安全：建立土城總部安全防災中心，可匯流各廠區即時安全訊息，針對颱風等天災建立防颱應變組織，提供即時安全防災資訊，並可針對應變人員進行應變訓練，強化集團安全防災體系。
- 6.安控及消防系統管理：納管廠區安防設備，平均妥善率99.5%；建置工業安全雲等模組，確保各廠安全軟硬體、管理機制到位。針對廠區電盤等電氣設備執行紅外線熱顯像儀檢測，成立紅外線熱影像推動小組培訓，共14位種子人員定期完成檢測報告，發現問題點並改善完成，有效降低廠區火災風險。

- 7.職業衛生：依照年度安全衛生管理計畫清查各單位物理及化學危害特性，完成含採樣策略之作業環境監測計劃書，監測結果皆合乎法令標準。參照法令指引完成四大計畫(不法侵害、人因、母性、過勞)，保護員工防止職業病發生及不法侵害情事等。
- 8.教育訓練與活動：107年辦理台灣廠區安全衛生健康月活動，活動主題包括：滅火器訓練、濃煙體驗、地震車體驗等項目，共計21場次，計13,990人次參與；並與大陸廠區連線辦理安全、健康、消防講座提升同仁相關意識。執行廠區安全稽核，共發現453件缺失並協助單位完成改善，以強化員工安全意識。

(五)關於退休制度：

本公司退休制度依據我國勞動基準法及勞工退休金條例辦理，包括：

- 1.勞動基準法(舊制)年資：採退休金確定給付制
 - a.員工退休申請：員工「工作十五年以上年滿五十五歲者」、「工作二十五年以上者」、「工作十年以上年滿六十歲者」，得自請退休。
 - b.員工退休金支付：以核准員工退休時一個月平均工資為員工退休金基數計算標準。按員工工作年資，每滿一年給與兩個基數；但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。惟依勞動基準法第五十四條因執行職務致符合強制退之員工，其退休金依前述規定加給20%。
 - c.員工退休準備金提撥：本公司依適用勞動基準法退休制度員工之每月薪資總額，按月提撥百分之二存儲於員工退休準備金專戶中，確保其不得作為讓與、扣押、抵銷或擔保之標的。另本公司於每年年度終了前，估算員工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估成就勞動基準法第五十三條或第五十四條第一項第一款退休條件之員工，依法計算之退休金數額者，本公司即於次年度三月底前一次提撥其差額。
 - d.員工退休金監督：於民國76年1月起依法成立勞工退休準備金監督委員會，委員會每三年改選一次，以複核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用、給付等事宜，確保勞工權益。
- 2.勞工退休金條例(新制)年資：採退休金確定提撥制
 - a.公司按月提撥6%退休金：依據勞工保險局發布的「勞工退休金月提繳工資分級表」，每月提撥員工工資的6%至員工個人退休金專戶。
 - b.員工個人退休金自提：員工亦可以依照個人意願，在其每月工資6%的範圍內自願提繳退休金。

(六)其他重要協議：無。

(七)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所受損失：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛或勞資爭議情事。

六、重要契約

契約性質	他方當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
買賣契約	Acer Inc.	2003/02/01 至 2004/01/31，如 期滿前雙方無終止之意思表 示，契約以 1 年期持續延 長。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	Apple Computer, Inc.	1999/12/07 至合約一方依合約 規定終止合約為止。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	Cisco Systems International B.V.	2014/7/27 起 1 年，如期滿前 雙方無終止之意思表示，契約 以 1 年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	Dell Products L.P.	1999/12/01 至 2000/11/30，如 期滿前雙方無終止之意思表 示，契約以 1 年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	EMC Corporation	2005/01/31-2006/01/30，如期 滿雙方無終止之意思表示時， 契約自動延長 1 年，自動延長 期間屆滿後亦同。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
專利授權 契約	FCI USA, Inc, & FCI America	2004/03 至專利期限屆滿日止。	專利授權	非專屬授權、 不可轉讓授權
買賣契約	Hewlett-Packard Company	2003/05/07-2008/05/06，如期 滿前雙方無終止之意思表示， 契約以 2 年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	International Business Machines Corporation	2008/07/07 至合約一方依合約 規定終止合約為止。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.	2003/11/04 起至一方按合約規 定終止合約	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
買賣契約	Microsoft Corporation	2009/10/27 起 5 年有效，契約 得因 Microsoft 提前 120 天通 知延續 1 年。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
專利授權 契約	Microsoft Corporation	2013/1/1-2019/12/31。	技術授權	非專屬授權、 不可轉讓授權
買賣契約	Motorola Inc.	2006/03/28 起 3 年，如期滿前 雙方無終止之意思表示，契約 持續延長，至任一方依合約規 定終止合約為止。	產品之買賣	保留變動交期 及訂單權利
專利授權 契約	MPEG LA	2009/12/28 至專利期限屆 滿日止。	技術授權	非專屬授權、 不可轉讓授權

契約性質	他方當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
授權契約	Nokia Corporation	2014/11/14 起有效至一方或雙方依照合約規定終止合約為止。	智慧財產權授權	非專屬授權、不可轉讓授權
買賣契約	Nokia Solutions and Networks Oy	2015/01/01 起 3 年，如期滿前雙方無終止之意思表示，契約以 1 年期持續延長。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
專利授權契約	Qualcomm Incorporated	2005/10/18 起有效至一方或雙方依照合約規定終止合約為止。	技術授權	非專屬授權、不可轉讓授權
買賣契約	Sony Corporation	2010/01/26 起有效 1 年，每年得自動延長 1 年。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Thomson Inc.	2008/03/31~2010/02/28，期滿後雙方得同意繼續延長。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Vizio Inc.	2014/01/01 起有效 1 年，如期滿前 90 日前，任一方若無終止之意思表示，則每屆期得自動延長 1 年。	產品之買賣	保留變動交期及訂單權利
買賣契約	Sharp Corporation	2016/04/02 起至一方按合約規定終止合約為止。	股權買賣	-